

SEMICON[®] JAPAN

2024開催報告

STRONGER
TOGETHER

半導体の未来が
ここにある。



SEMICON[®]
JAPAN

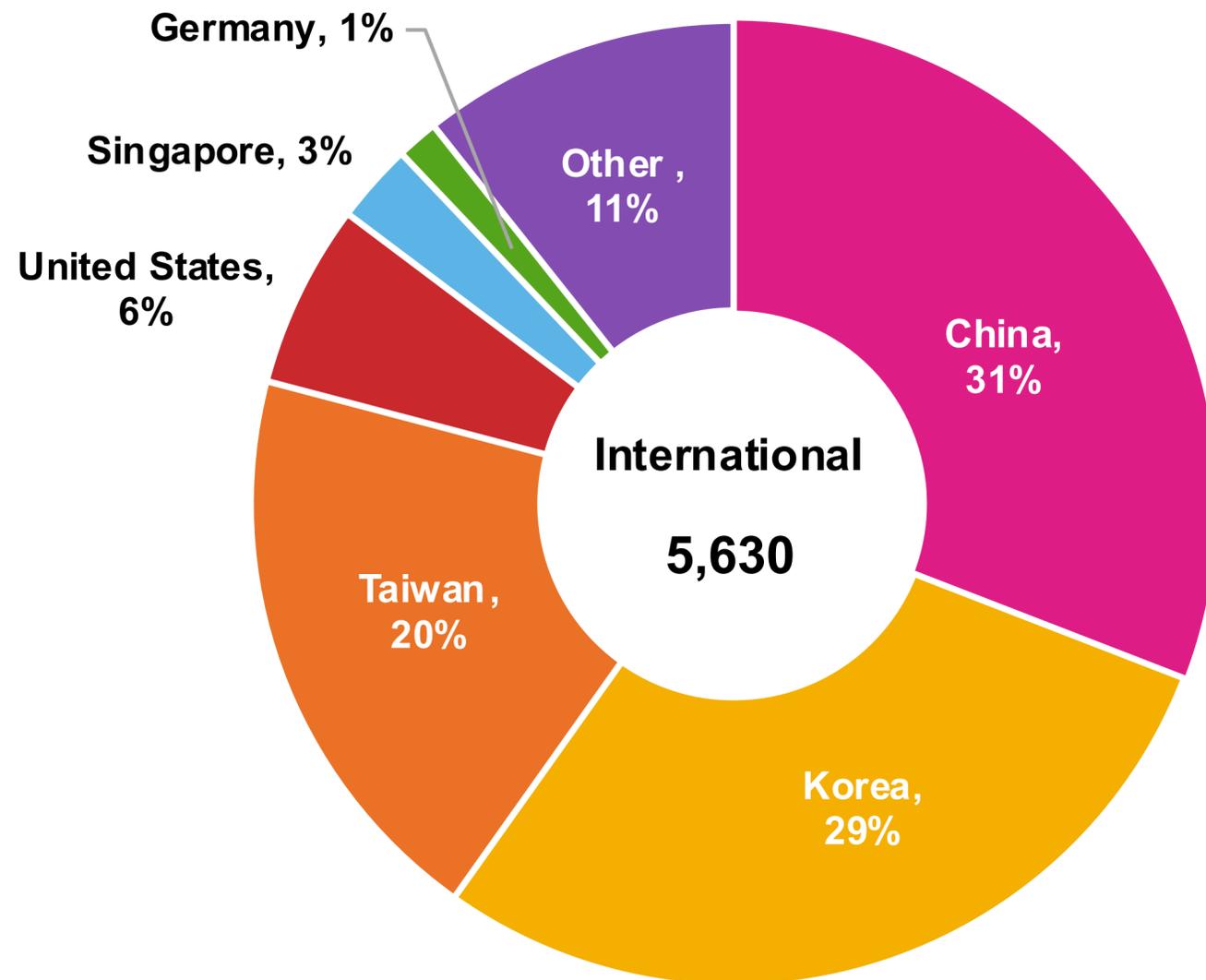
SEMICON® JAPAN 2024年開催実績

会期： 2024年12月11日(水)～13日(金)
会場： 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟
主催： SEMI
テーマ： 半導体の未来がここにある。

実績：

・ 出展者数：	1,107	(961)	
・ 小間数：	2,789	(2,265)	
・ 出展面積 (m ²)：	24,093	(19,595)	
・ 国数：	35	(19)	
・ 延べ来場者数：	103,165	(85,282)	
・ 来場者実数：	45,698	(36,188)	※ ()は前回実績

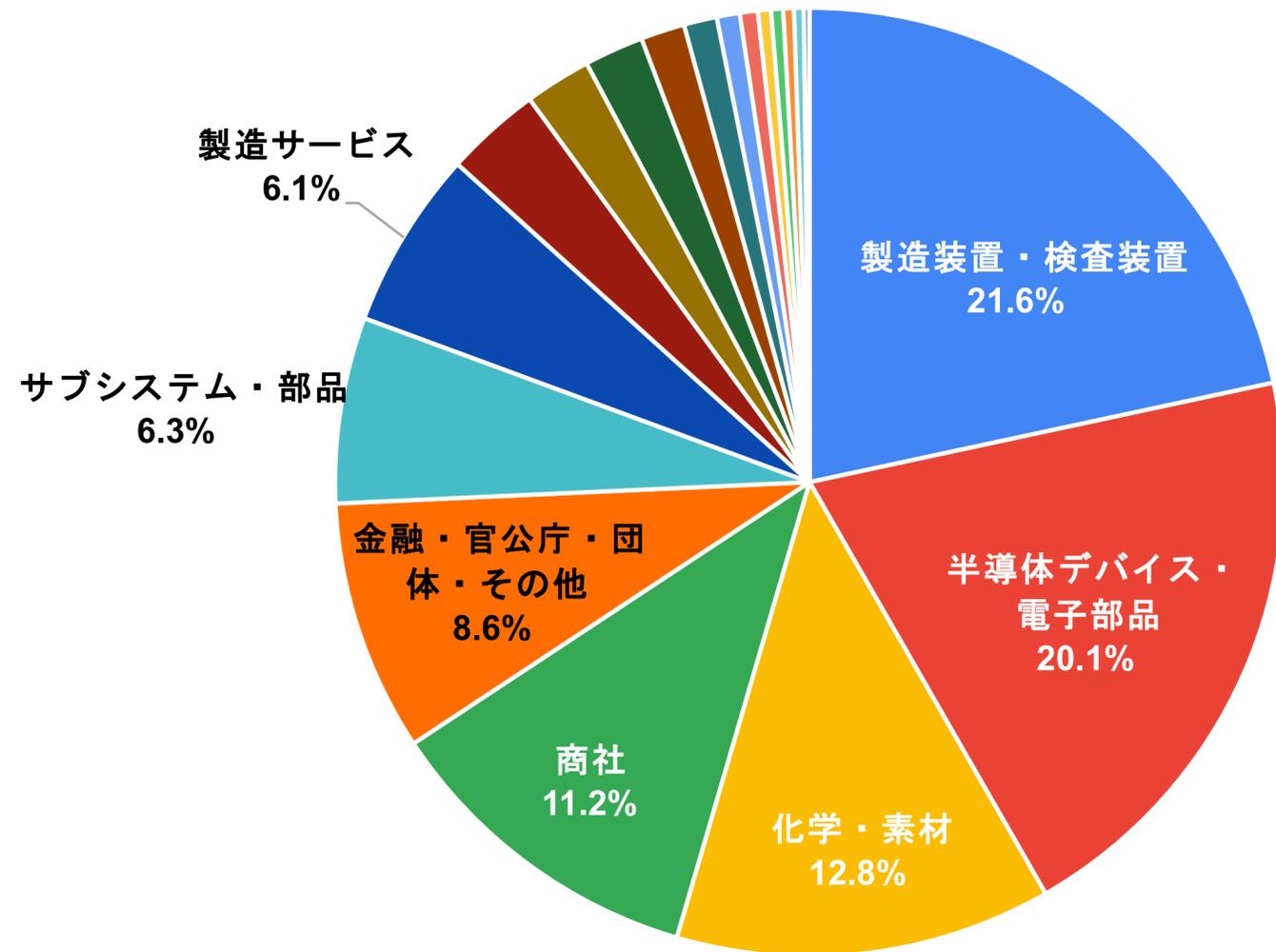
来場者属性－海外来場者



- 実来場者数5,630名。2023年比で22%増加。
- 実来場者全体での比率は12.3%と前年と同レベル。
- 中国・韓国・台湾が多く of 比率（計80%）を占める傾向は前年と同じ。



来場者属性一業種



製造装置・検査装置.....	21.6%
半導体デバイス・電子部品.....	20.1%
化学・素材.....	12.8%
商社.....	11.2%
金融・官公庁・団体・その他.....	8.6%
サブシステム・部品.....	6.3%
製造サービス.....	6.1%
IT機器・家電・電子機器.....	3.3%
通信・情報サービス.....	2.3%
大学生.....	2.0%
自動車・輸送機器.....	1.5%
大学院修士課程.....	1.1%
プリント基板.....	0.8%
その他学生.....	0.6%
プレス.....	0.4%
高等専門学校.....	0.4%
医療・ヘルスケア.....	0.4%
EDA・IP.....	0.3%
大学院博士課程.....	0.2%

・「製造装置・検査装置」、「半導体デバイス・電子部品」、「化学・素材」の3項目で半数以上を占める

来場者属性—所属部門

セールス.....	20.2%	広報.....	0.6%
マーケティング、セールス、ビジネス開発.....	9.6%	テスト.....	0.6%
研究開発（R&D）.....	8.8%	製品管理.....	0.5%
設計.....	6.3%	ロジスティクス/サプライチェーン管理.....	0.5%
企業経営.....	5.7%	人事.....	0.5%
企業管理者.....	4.1%	財務/会計.....	0.4%
経営管理/取締役会メンバー.....	3.4%	施設/エンジニアリングサポート.....	0.3%
製造エンジニアリング.....	3.4%	広告.....	0.3%
製造/オペレーション管理/生産.....	3.3%	環境、健康、安全（EHS）.....	0.3%
化学/材料.....	3.1%	投資家関係.....	0.3%
購買/調達/オフィス管理.....	2.4%	行政サポート.....	0.3%
製造およびプロセスエンジニアリング.....	2.2%	メディア/プレス.....	0.3%
ビジネス開発.....	2.0%	統合/ITサポート.....	0.3%
エンジニアリング その他.....	1.9%	トレーニング/教育.....	0.2%
ソフトウェアエンジニアリング.....	1.7%	組み立て/パッケージングエンジニアリング.....	0.2%
学術.....	1.4%	パッケージング/組み立て.....	0.2%
産業エンジニアリング.....	1.3%	マーケットアナリスト.....	0.2%
金融/業界アナリスト/投資家関係.....	1.3%	トレードショー/イベント.....	0.1%
装置エンジニアリング.....	1.3%	その他.....	7.3%
コンサルティング.....	1.3%		
品質保証/故障解析/信頼性.....	0.8%		
政府/公共政策.....	0.8%		

来場者属性－職務レベル

経営者・会社役員	12%
上級管理職	15%
その他マネジメント	20%
一般職員	45%
学生	4%
その他	3%

- ・ 経営・マネジメント層で全体の47%を占める



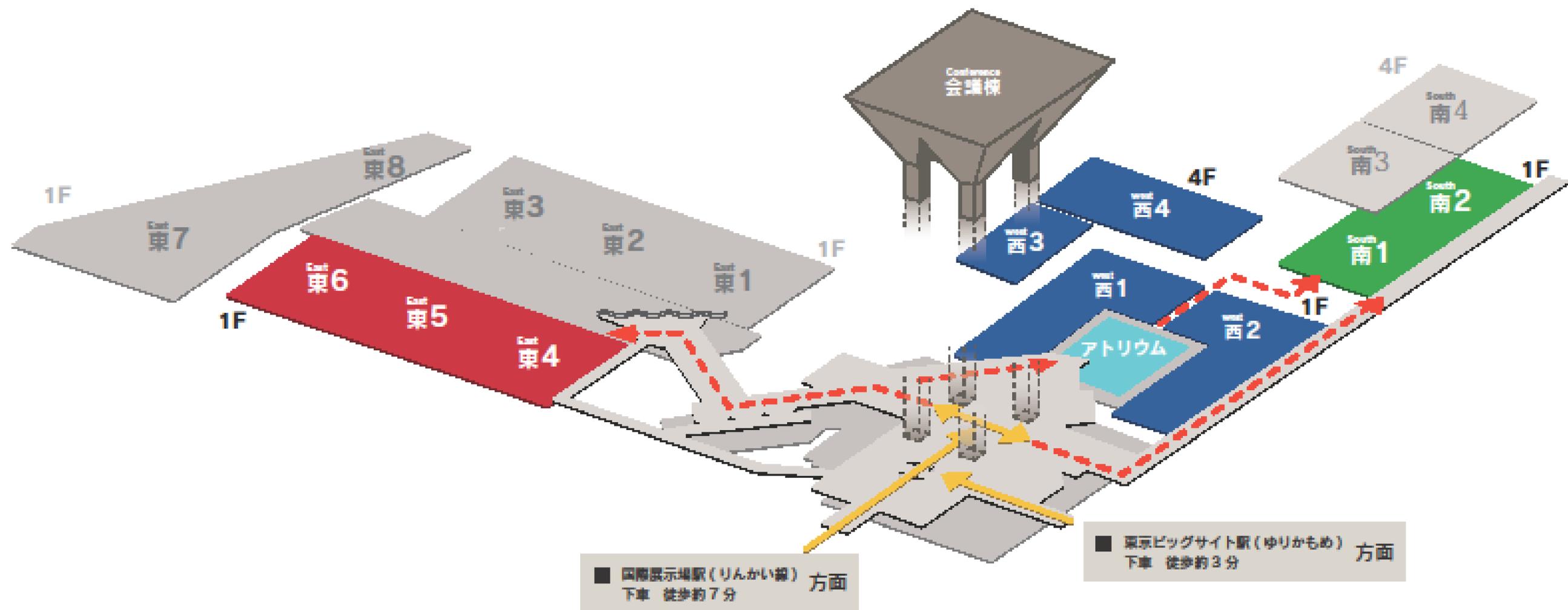
会場を訪れた半導体デバイスメーカー



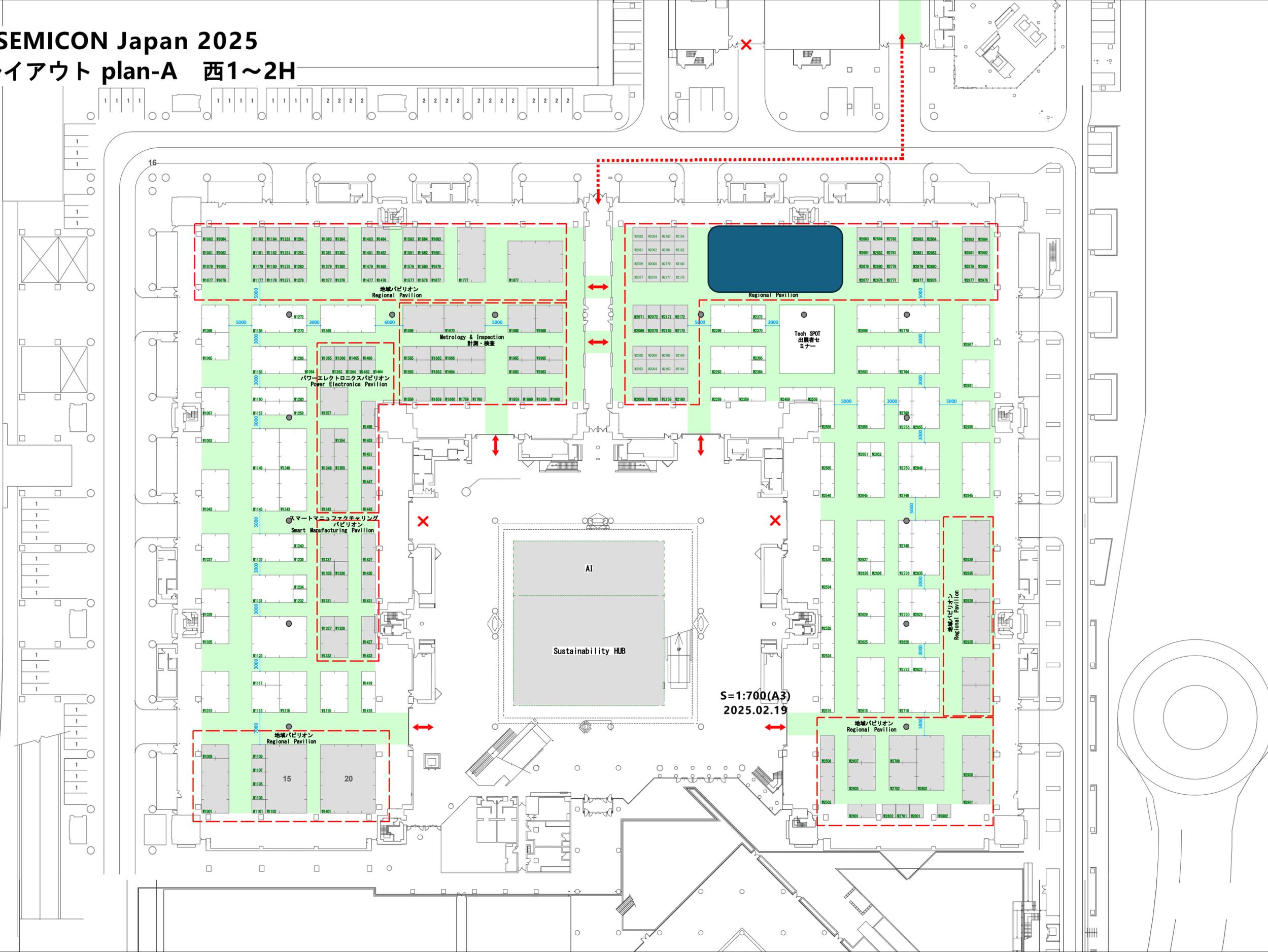
IBM
旭化成エレクトロニクス
Intel
Infineon Technologies
Western Digital
エイブリック
SK ハイニックスジャパン
オムロン
オリジン
キオクシア
キャノン
京セラ
KOA
コーデンシ
コニカミノルタ
Samsung Electronics
Samsung Electro-Mechanics
サンケン電気
三社電機製作所
シチズンファインデバイス

シャープ
ジャパンセミコンダクター
ジャパンディスプレイ
新電元工業
Skyworks Solutions
スタンレー電気
住友電気工業
セイコーインスツル
セイコーNPC
セイコーエプソン
ソニーセミコンダクタソリューションズ
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
太陽誘電
太陽誘電モバイルテクノロジー
TSMC
TDK
Texas Instruments
デンソー
東芝デバイス&ストレージ
トーキン

豊田合成
日亜化学工業
ヌヴォンテクノロジージャパン
パナソニック
浜松ホトニクス
フェニテックセミコンダクター
富士電機
双葉電子工業
ボールウェーブ
マイクロンメモリジャパン
三菱電機
ミツミ電機
村田製作所
メルコセミコンダクタエンジニアリング
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン
ラピスセミコンダクタ
ルネサスエレクトロニクス
ローム



SEMICON Japan 2025 仮レイアウト plan-A 西1~2H



1社あたりの面積は、2m X 1.5m = 3m²
展示台は 1.4 m X 0.9m

